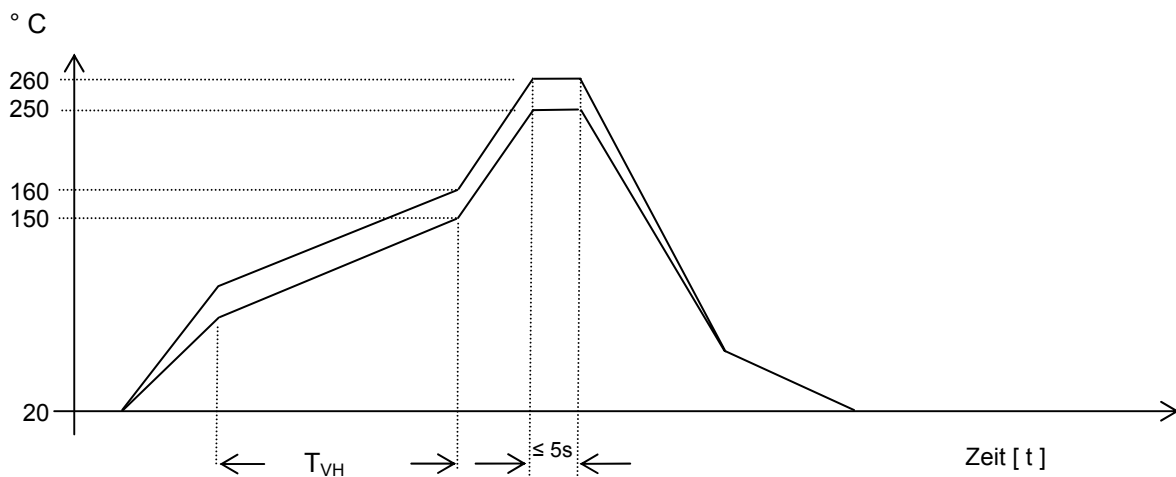


Das Lötprofil für das Wellenlöten wird im wesentlichen bestimmt durch Lötfestigkeit der elektronischen Komponenten. Durch kürzere Verweildauer in der Lötwellen und geringere Temperaturen werden die Komponenten weniger gestresst. Es ist deshalb üblich für alle auf der Leiterplatte befindlichen Komponenten die Parameter zu ermitteln, bei denen ein gutes Lötgergebnis bei geringer Temperaturstressung erzielt wird.

Bei Relais gilt allgemein, dass die Anschlüsse kleiner Relais eine geringere Wärmekapazität haben als grössere Relais und damit die Verweildauer in der Lötwellen kürzer sein darf. Relais mit einer Grundplatte aus einem duroplastischen Material (thermosetting) (Serie 55, 56, 60, 62, 65) können dagegen länger in der Lötwellen verweilen.

Die Finder-Relais sind mit folgender Lötwellen geprüft worden.

Empfohlenes Lötprofil (Wellenlöten) für Finder Relais und bleifreie Lote



T_{VH} = Vorheizzeit ist abhängig von der Wärmekapazität (Dicke der Leiterplatte) und der Transportgeschwindigkeit

Empfehlungen bei Kolbenlötung

Temperatur ≤ 280 °C maximal 5 s
Kolbenleistung: max. 50 W